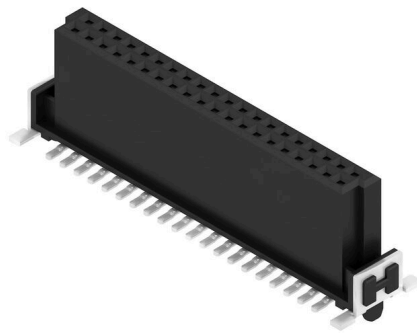


제품 이미지



OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터  
컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링  
미래 대비형 컨택트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는  
효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서  
그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드  
투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해  
최대한의 유연성을 제공합니다.

- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의 유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정 기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을 적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP 소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고접점 중첩이 있어 12~80개 풀까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결 조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

일반 주문 데이터

버전	PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, SMD 용접 결선, 피치(mm)(P): 1.27 mm, 극 수: 40, 180°, Tape
주문 번호	<a href="#">2747390000</a>
유형	FFH9 S1/40V F1 B RL
GTIN (EAN)	4064675000761
수량	280 items
제품 데이터	IEC: / 2.8 A UL: 150 V
패키징	Tape

FFH9 S1/40V F1 B RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E92202

치수 및 중량

깊이	7.8 mm	깊이 (인치)	0.3071 inch
높이	9.9 mm	높이 (인치)	0.3898 inch
너비	30.48 mm	폭 (인치)	1.2 inch
순중량	6.26 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

전송 속도	3.125 Gbit/s	제품군	OMNIMATE 신호 - 보드 투 보드
결선 유형	보드 결선	PCB에 장착	SMD 용접 결선
피치(mm)(P)	1.27 mm	피치(인치)(P)	0.050 "
외향 앵글	180°	극 수	40
플랫 용접 핀 수	1	공면:	0.1 mm
행 수	1	핀 시리즈 수량	2
보호 등급	IP20	볼륨 저항	<25 mΩ
플러그 주기	500	플러깅 힘/폴, 최대	0.6 N
당기는 힘 / 폴, 최대	0.6 N		

자재 데이터

절연재	LCP	컬러 코드	검정
컬러 차트(유사)	RAL 9011	절연재 그룹	IIIa
절연 저항	≥ 10 <sup>10</sup> Ω	Moisture Level (MSL)	1
UL 94 가연성 등급	V-0	접점 기본 재질	구리 합금
접점 재질	구리 합금	접점 표면	금 도금 니켈
플러그 접점의 레이어 구조	≥ 2 μm Ni / ≥ 0.4 μm PdNi / ≥ 0.05 μm Au	보관 온도, 최소	-40 °C
보관 온도, 최대	70 °C	작동 온도, 최소	-55 °C
작동 온도, 최대	125 °C		

IEC 정격데이터

정격 전류, 극 수(Tu=20°C)	2.8 A	연면거리, 분	0.4 mm
최소간격, 분	0.4 mm		

UL 1977에 따른 정격 데이터

승인값 참조	사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조	정격 전압(UL 1977)(구형)	150 V
--------	------------------------	--------------------	-------

기술 데이터

패키징

패키징	Tape	VPE 길이	350.00 mm
VPE 폭	345.00 mm	VPE 높이	135.00 mm

중요 참고 사항

IPC 준수	적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.
--------	--

참고 사항

분류

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

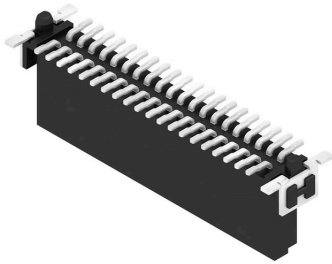
FFH9 S1/40V F1 B RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

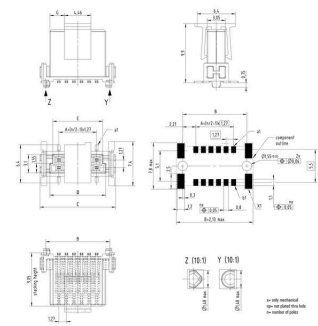
도면

제품 이미지



Dimensional drawing

Type	Order no.	No. of poles	A	B	C	D	E	G
FFH9 S1/27V F1 B RL	2347140000	12	45.26	82.11	82.2	82.2	82.2	2.48
FFH9 S1/30V F1 B RL	2347260000	18	6.89	13.21	15.24	17.91	18.81	3.73
FFH9 S1/30V F1 B RL	2347300000	24	11.43	19.83	21.78	24.45	24.45	5
FFH9 S1/30V F1 B RL	2347330000	28	15.24	28.45	31.53	34.2	34.2	7.34
FFH9 S1/30V F1 B RL	2347380000	31	18.81	34.2	37.29	40.2	40.2	8.81
FFH9 S1/30V F1 B RL	2347390000	36	24.45	43.83	46.8	49.8	49.8	11.33
FFH9 S1/30V F1 B RL	2347400000	40	28.11	52.45	55.41	58.41	58.41	13.33
FFH9 S1/30V F1 B RL	2347410000	46	36.81	68.43	71.41	74.41	74.41	16.33
FFH9 S1/30V F1 B RL	2347420000	50	41.91	77.05	80.01	83.01	83.01	18.33
FFH9 S1/30V F1 B RL	2347430000	56	49.83	93.03	96.01	99.01	99.01	21.33
FFH9 S1/30V F1 B RL	2347440000	60	55.41	101.65	104.61	107.61	107.61	23.33

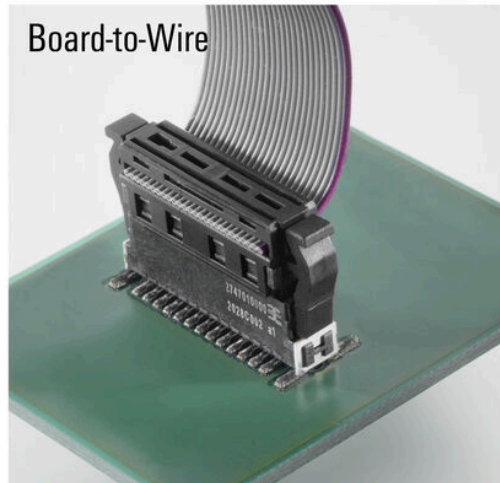
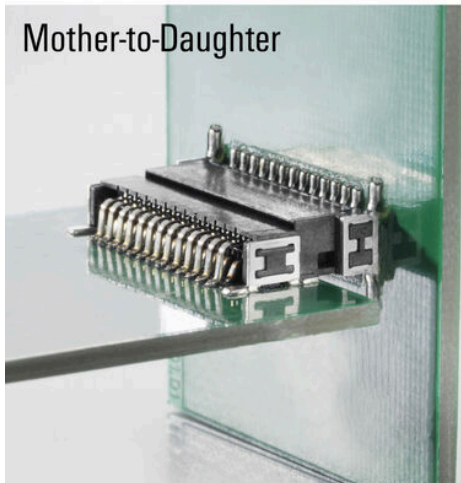
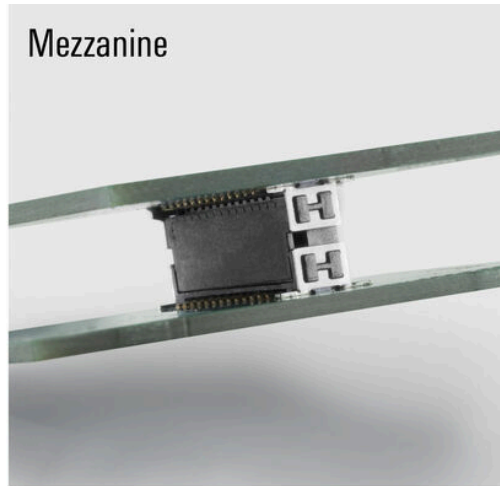
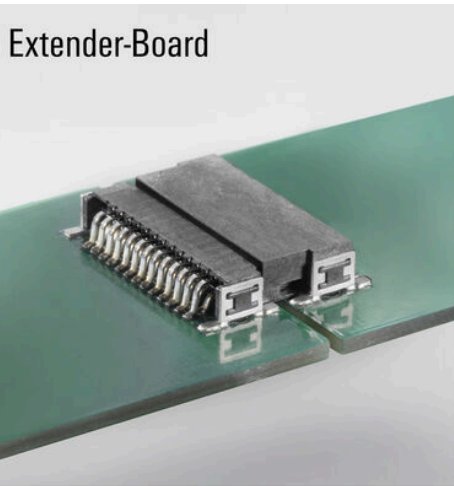


상세 도면



감소 곡선





**FFH9 S1/40V F1 B RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

대응물

**FMH - 수형 헤더, 보드 결선**



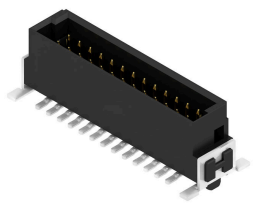
OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터  
 컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링  
 미래 대비형 컨택트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는  
 효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서  
 그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드  
 투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해  
 최대한의 유연성을 제공합니다.

- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의 유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정 기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을 적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP 소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고점점 중첩이 있어 12~80개 풀까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결 조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

일반 주문 데이터

유형	FMH S1/40V F1 B RL	버전	
주문 번호	<a href="#">2747210000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, SMD 용접 결선, 피치(mm)(P): 1.27	
GTIN (EAN)	4064675001034	mm, 극 수: 40, 90°, Tape	
수량	560 ST		

**FMH1 - 수형 헤더, 보드 결선(스택 높이 1.75mm)**



OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터  
 컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링  
 미래 대비형 컨택트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는  
 효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서  
 그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드  
 투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해  
 최대한의 유연성을 제공합니다.

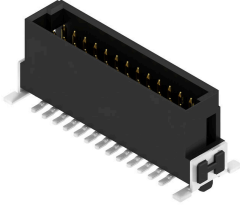
- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의 유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정 기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을 적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP 소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고점점 중첩이 있어 12~80개 풀까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결 조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

일반 주문 데이터

유형	FMH1 S1/40V F1 B RL	버전	
주문 번호	<a href="#">2747030000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, SMD 용접 결선, 피치(mm)(P): 1.27	
GTIN (EAN)	4064675001485	mm, 극 수: 40, 180°, Tape	
수량	280 ST		

대응물

FMH3 - 수형 헤더, 보드 결선(스택 높이 3.25mm)



OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터  
컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링  
미래 대비형 컨택트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는  
효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서  
그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드  
투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해  
최대한의 유연성을 제공합니다.

- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의 유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정 기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을 적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP 소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고접점 중첩이 있어 12~80개 폴까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결 조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

일반 주문 데이터

유형	FMH3 S1/40V F1 B RL	버전	
주문 번호	<a href="#">2747120000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, SMD 용접 결선, 피치(mm)(P): 1.27	
GTIN (EAN)	4064675001164	mm, 극 수: 40, 180°, Tape	
수량	280 ST		